

Title (en)

Process for regenerating hydrochloric acid from pickling installations.

Title (de)

Verfahren zur Regenerierung von Salzsäure aus Beizanlagen.

Title (fr)

Procédé de régénération d'acide chlorhydrique à partir d'installations de décapage.

Publication

EP 0635586 A1 19950125 (DE)

Application

EP 94110417 A 19940705

Priority

AT 144993 A 19930721

Abstract (en)

In order to reduce the pollutants in the exhaust gas of regeneration plants for used hydrochloric acid from pickling plants, a process is provided including the thermal cleavage of iron chloride in the used pickling acid to give iron oxide and gaseous hydrochloric acid, at least one compound being added to the used pickling acid which contains nitrogen having a low oxidation number, for example ammonium compounds, ammonia, urea or amides. <IMAGE>

Abstract (de)

Um die Schadstoffe im Abgas von Regenerierungsanlagen für verbrauchte Salzsäure aus Beizanlagen zu reduzieren, ist ein Verfahren vorgesehen, umfassend die thermische Spaltung von Eisenchlorid in der verbrauchten Beizsäure zu Eisenoxid und gasförmiger Salzsäure, wobei der verbrauchten Beizsäure zumindest eine Verbindung zugemischt wird, die Stickstoff mit niedriger Oxidationszahl enthält, beispielsweise Ammoniumverbindungen, Ammoniak, Harnstoff oder Amide. <IMAGE>

IPC 1-7

C23G 1/36

IPC 8 full level

G03C 5/395 (2006.01); **C01B 7/01** (2006.01); **C02F 1/02** (2006.01); **C23G 1/36** (2006.01)

CPC (source: EP US)

C23G 1/36 (2013.01 - EP US); **Y10S 423/01** (2013.01 - EP US)

Citation (search report)

- [A] FR 1309534 A 19621116 - OTTO SAUEREBAU UND KERAMIKWERK
- [A] US 3443991 A 19690513 - KREMM GEORGES F
- [A] MACHU W.: "Über das Beizen von Warmband mit Salzsäure und die totale Regeneration", WERKSTOFFE UND KORROSION, vol. 18, no. 8, 1 August 1967 (1967-08-01), WEINHEIM DE, pages 673 - 680

Cited by

AT403665B; DE10006990B4; WO2024132555A2; US6692719B1; WO0238819A3

Designated contracting state (EPC)

BE DE FR IT NL SE

DOCDB simple family (publication)

EP 0635586 A1 19950125; **EP 0635586 B1 19960612**; AT 399516 B 19950526; AT A144993 A 19941015; DE 59400348 D1 19960718; JP 3531840 B2 20040531; JP H07173657 A 19950711; TW 265322 B 19951211; US 6210650 B1 20010403

DOCDB simple family (application)

EP 94110417 A 19940705; AT 144993 A 19930721; DE 59400348 T 19940705; JP 15847894 A 19940711; TW 83105776 A 19940625; US 28094594 A 19940727